

Lundi 8	Mardi 9 juin		Mercredi 10 juin		Jeudi 11 juin		Vendredi 12 juin	
	8:30 – 10:00		8:30 – 10:00		8:30 – 10:00		9:00 – 11:00	
	8:30 – 9:00 <i>Ouverture et présentation de l'atelier</i>	Session 2 <i>Apport de l'intelligence artificielle dans l'analyse de défaillance</i>	MA 1 <i>Contrôle non destructif</i>	Tutoriel 5 <i>Technologie et analyse de défaillance des relais</i>	MA 5 <i>Packaging, PCB et assemblages</i>	Tutoriel 7 <i>Tests électriques pour l'analyse de défaillance</i>	MA 7 <i>Contrefaçon ou défaut de fabrication ?</i>	
11h	10:15 – 12:15		10:30 – 12:00		10:30 – 12:00			
Ouverture de l'accueil	Tutoriel 3 <i>Microscopie électronique/ionique FIB</i>	Session 1 <i>Packaging, PCB et Assemblages</i>	Session 2 <i>Apport de l'intelligence artificielle dans l'analyse de défaillance</i>	MA 2 <i>Connectique</i>	Session 5 <i>Défiabilisation des composants dans le process industriel ou en utilisation</i>	MA 5 <i>Packaging, PCB et assemblages</i>	11:15 – 11:45	
12h00/14h00 Déjeuner	Déjeuner		Déjeuner		Déjeuner		Déjeuner	
14h00-16h00	14:00 – 16:00		14:00 – 16:00		14:00 – 16:00		14:00	
Tutoriel 1 <i>Techniques d'analyses non destructives : X ray Tomographie X</i>	Tutoriel 4 <i>Analyse de surface</i>	Session 1 <i>Packaging, PCB et Assemblages</i>	MA 3 <i>Fonctionnement d'un labo d'analyse : les pièges à éviter</i>	Session « Analyse de défaillance des composants passifs	Tutoriel 6 <i>Procédés d'assemblage</i>	Session 5 <i>Défiabilisation des composants dans le process industriel ou en utilisation</i>	Départ	
16:30 – 18:00	16:30 – 18:00		16:30 – 18:00		16:30 – 18:00			
Tutoriel 2 <i>Techniques électroniques pour la localisation de défauts</i>	Open questions	Session 1 <i>Packaging, PCB et Assemblages</i>	Session 4 <i>Analyse de défaillance des circuits intégrés VLSI</i>	MA 4 <i>Impact normes et législations sur l'analyse de défaillance</i>	Open questions	MA 6 <i>Nouveaux composants, nouveaux défis.</i>	ATELIER 2026 19ème atelier ANADEF	